

Dreams Designed, Driven by AI



피아이는 AI를 도입하고자 하는 다양한 산업, 다양한 고객들에게
All-In-One Total AI solution을 제공하고자 합니다.

DISCLAIMER

본 자료는 주식회사 피아이이의 기업설명과 관련한 정보제공을 목적으로 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 시장 전망 등 "예측정보"는 당사에서 수집된 정보와 당사의 전망치이며 향후 수정 및 변경 될 수 있습니다.

본 자료의 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 영향을 받으며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임을 부담하지 않음을 알려 드립니다. 본 자료는 주식의 모집 또는 매출, 투자 및 매매의 권유를 구성하지 아니하며 본 자료의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 법적근거가 될 수 없습니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용 가능하나 출처의 표시는 필수사항입니다.

Table of Contents



Prologue

Chapter1
**Company
Overview**

Chapter2
**Investment
Highlights**

Chapter 3
**Growth
Momentum**

Appendix

02 AI 확산과 산업 구조 변화

AI는 이미 B2C real life 전반에 확산,
→ Physical AI 등 B2B 중심의 산업 도메인 AX 가속화

B2C · 실생활 AI

e-Commerce
추천 · 검색 · 광고 개인화

Finance
상담 자동화 · 신용평가 · 이상거래 탐지

LLM 중심 · 소비자 경험

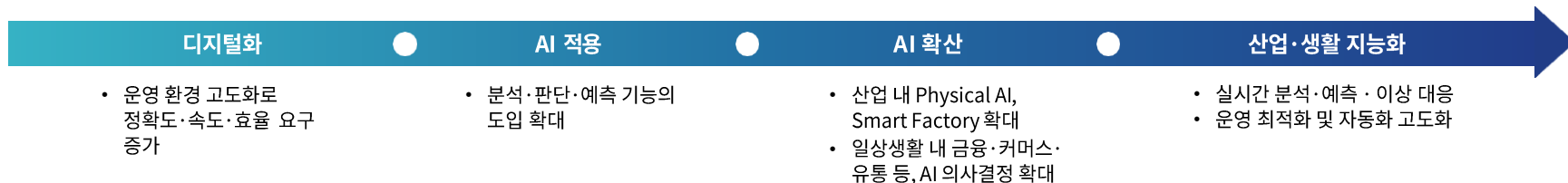


B2B · 산업 AI

Physical AI
군집제어 · 운영 최적화 · 이상탐지

Smart Factory
지능화 · 예지보전 · 품질 관리

Physical AI 중심 · 생산성 향상



02 Transformation

P.A.R.C 중심 (PIE AI R&D Campus) → AX 가속화 | B2B 기반 AI 사업 확장



R&D 기반 4대 핵심 전략

<p>P.A.R.C. 중심 AX</p> <p>P.A.R.C. 및 Data Ops / AI Ops 기반 AI 연계 사업 확대</p> <p>AI 역량 내재화 고도화 및 알고리즘 최적화</p> <p>기존 Vision 검사에 AI 분석 Layer 추가</p>	<p>고부가가치 장비 Biz. (AX사업부)</p> <p>고부가가치 검사장비 사업 본격화</p> <p>유리기판·반도체·오토모티브 신규 시장 대응</p> <p>하이엔드 포트폴리오 재편 및 수익성 강화</p>	<p>Physical AI/무인자동화</p> <p>AMR·Auto Teaching·RFM 등 로봇틱스/자동화 적용 확대</p> <p>제조 현장 물리적 제어와 AI 기술 융합</p> <p>스마트팩토리 실행 영역 확장</p>	<p>AI 통합 솔루션 강화</p> <p>검사·데이터·자동화 결합 End-to-End 제안</p> <p>PIE-PIR-AHL 계열사간 공동 대응 시너지</p> <p>하드웨어와 소프트웨어의 통합</p>
---	---	--	--

01 사업영역

02 비즈니스 모델

03 성장 연혁

04 기업 현황

01

Company Overview

 **PIE**

Investor Relations 2026

AI 기반 Smart Factory Total Solution을 B2B 고객에게 제공

M/V Solution(S/W)

- AI 비전 검사 솔루션
- 배터리 중심 레퍼런스 기반
- 다산업 적용 기반

AI 기반 검사장비(H/W)

- 고부가가치 검사 장비
- 유리기판·PCB·반도체·오토모티브
- AX 포트폴리오 확대

AI 기반 Smart Factory Total Solution

AI Observability

- 검사·공정·설비 데이터 통합
- 모니터링·분석·예측
- 운영 최적화/품질 일관성

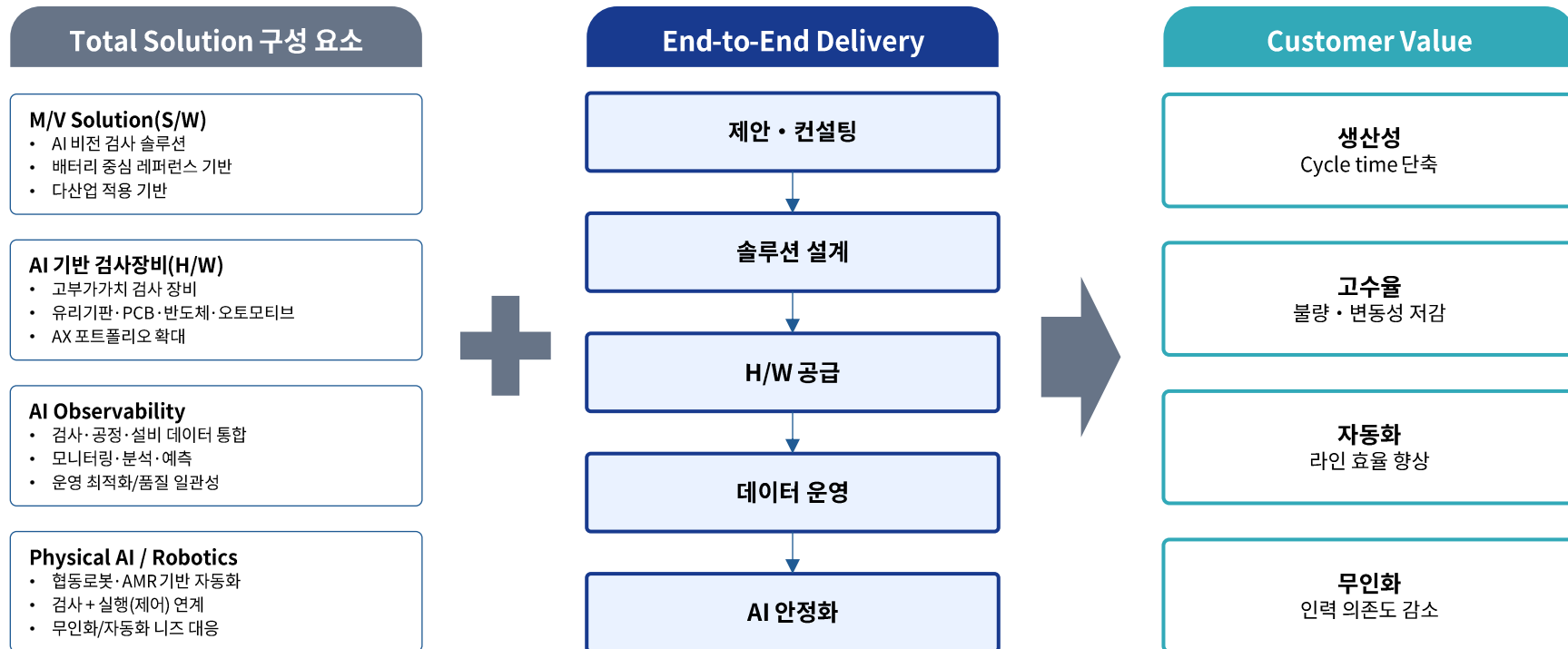
Physical AI / Robotics

- 협동로봇·AMR 기반 자동화
- 검사 + 실행(제어) 연계
- 무인화/자동화 니즈 대응

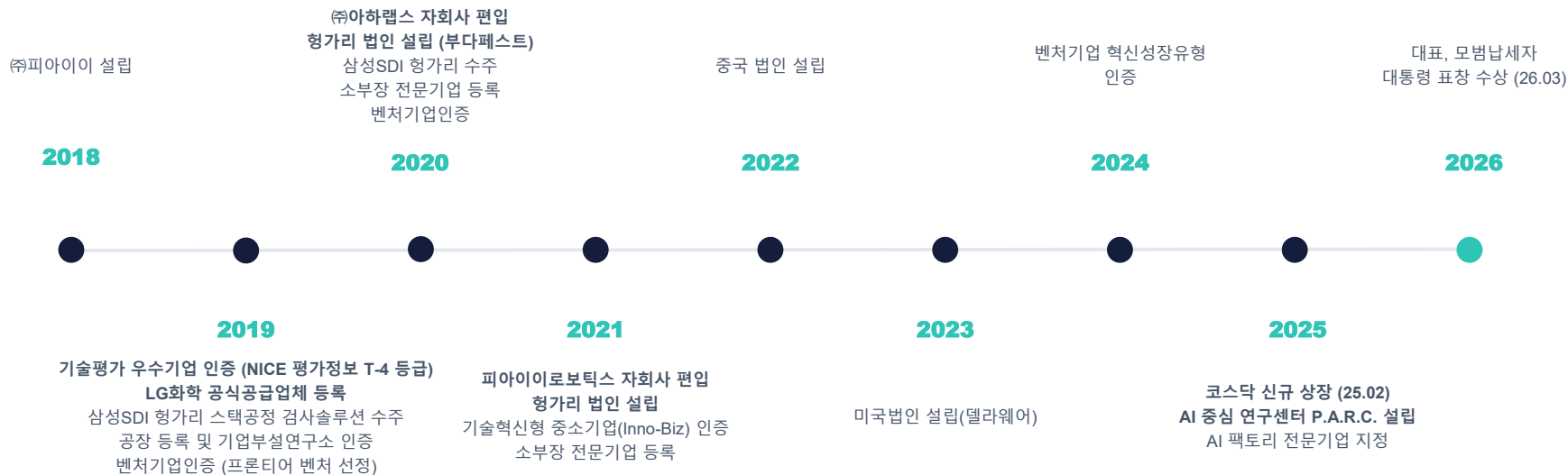
※ M/V : Machine Vision

02 비즈니스 모델

AI 기반 검사, AI Observability, Physical AI를 융합, AX를 추진하는 고객 대상 Total Package 제공



03 성장 연혁



04 기업 현황

AI 비전 및 Data 기반 스마트팩토리 솔루션을 공급하는 산업 지능화 혁신의 리더


회사소개

회사명	주식회사 피아이이
사업영역	AI 비전 솔루션, Data 기반 스마트팩토리 솔루션
임직원수	181명
자본금	36억원
법인설립일	2018년 7월
본사주소	경기도 화성시 동탄기흥로 614, 더퍼스트타워 2차19F
계열사	아하랩스, 피아이이로보틱스
홈페이지	www.piegroup.co.kr



국내외 특허

국내	PI(Polyimide) 필름 양산 공정 표면 결함의 3차원 검사 및 리뷰 장치	3D 비전 검사기	2021.03.30출원
국내	하프 미러 편향 측정 방법을 기반한 PI 필름 고정밀 3D 리뷰 시스템	3D 비전 검사기	2021.03.30출원 2024.03.19등록
국내	3D 이미지 결함 측정 시스템 및 그 방법	3D 비전 검사기	2021.05.13출원 2024.06.25등록
국내	초음파 워터폴 방식 검사 장치	초음파 검사기	2021.10.28출원 2024.06.25등록
국내	유료 길이가 변형 초음파 워터폴 방식 검사 장치	초음파 검사기	2021.10.28출원
국내	초음파 영상 기반 구조 결함 검사를 위한 배열소자 변환기	초음파 검사기	2022.11.25출원
국제	초음파 영상 기반 구조 결함 검사를 위한 배열소자 변환기	초음파 검사기	2022.11.28출원
국내	파우치 셀의 알루미늄 노출 검사방법 및 장치	비전 검사기	2023.11.27출원
국내	다중 초점 방식의 TGV 유리 기판 검사 장치	비전 검사기	2024.11.08출원
국내	멀티 조명 영역별 파장 분할 조사를 이용하는 광학 검사장치	비전 검사기	2024.11.12출원

- 
- 01 AX, driven by R&D
 - 02 Why PIE is Unique
 - 03 수직/수평 사업 스펙트럼 고도화
 - 04 2026~2027년 주요 모멘텀
 - 05 신규사업 매출 가시화, AX사업부

02

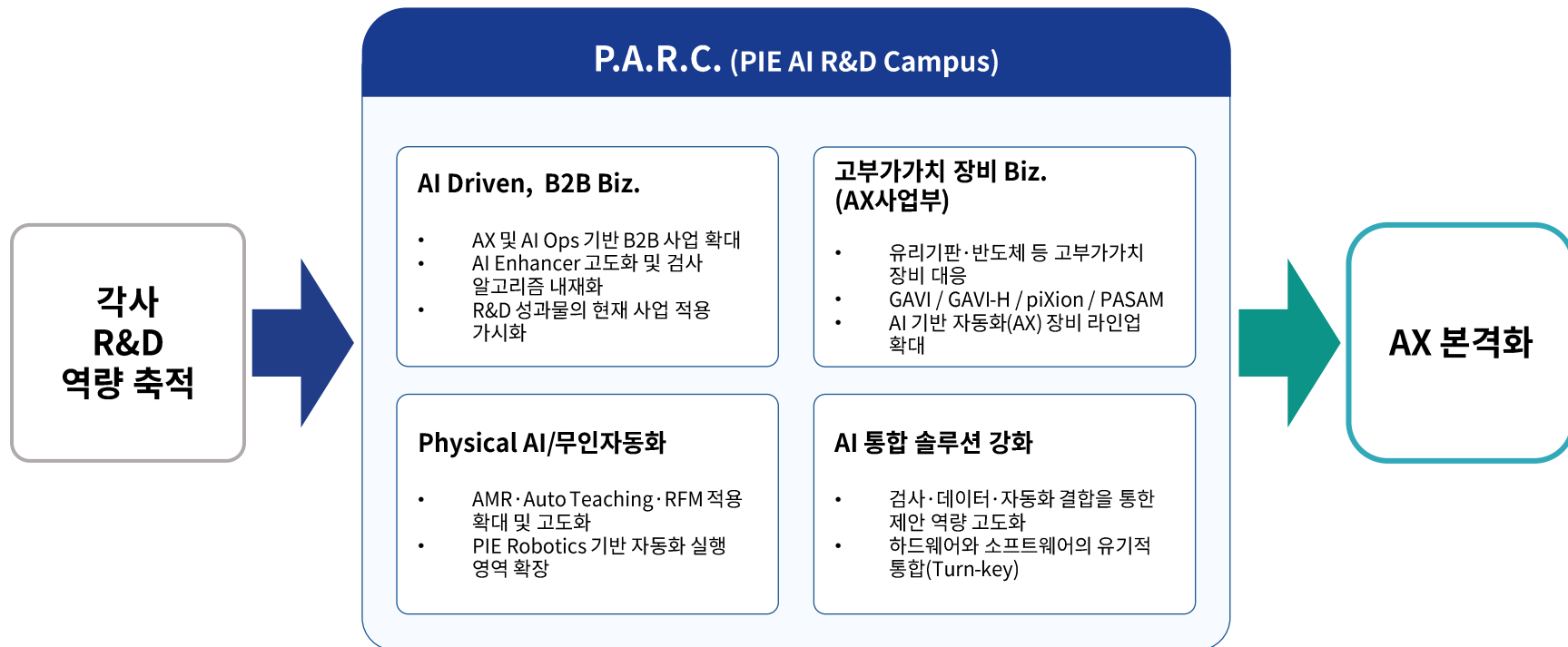
Investment Highlights



Investor Relations 2026

01 AX, driven by R&D

P.A.R.C. 및 축적된 R&D 성과를 바탕으로 AX 본격화



02 Why PIE is Unique

개별 기술이 아닌 “AI 기반 검사 + 데이터·자동화”를 아우르는 통합 커버리지 제공

경쟁사

단일 레이어 중심 접근

- H/W 또는 Vision S/W 개별 공급
- 데이터/자동화 연계 부족

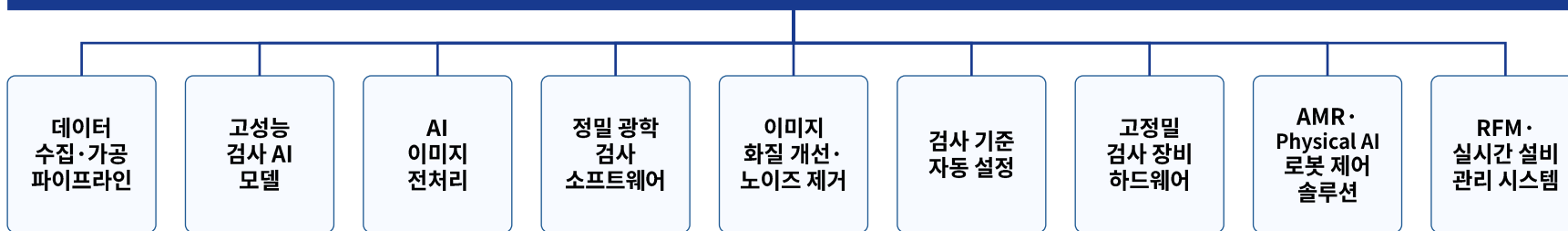
VS

PIE

AI Full-Stack Total Solution 제공

- 검사(Vision) + 분석(Data) + 실행(Robot) 통합 제안
- Turn-key 수주 가능

AI Full-Stack Total Solution Coverage



↑ Full-Stack Integration Synergy ↑

03 수직/수평 사업 스펙트럼 고도화

전방 산업 확대 + AI 기술 Layer 고도화

PIE + PIE Robotics + AHHA Labs

그룹사 공동 수주 기반으로 단일 장비 납품을 넘어
턴키(Turn-key) 솔루션 제공 역량 확보

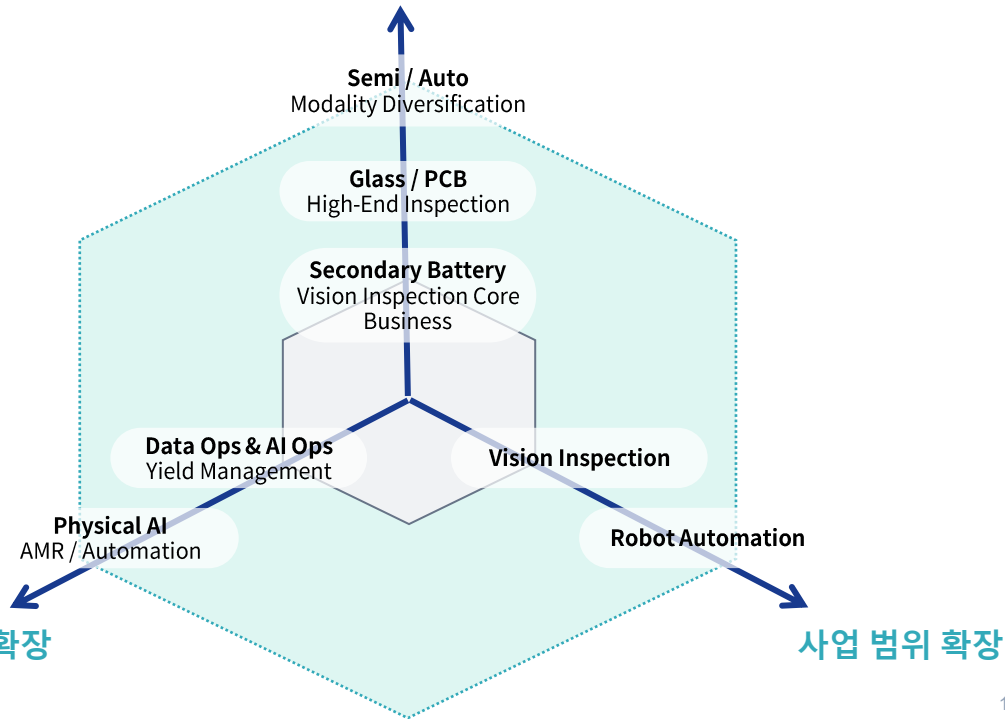
Risk Management

특정 산업 사이클 변동 리스크를 분산하고
안정적 수익 구조 마련

AI Total Solution

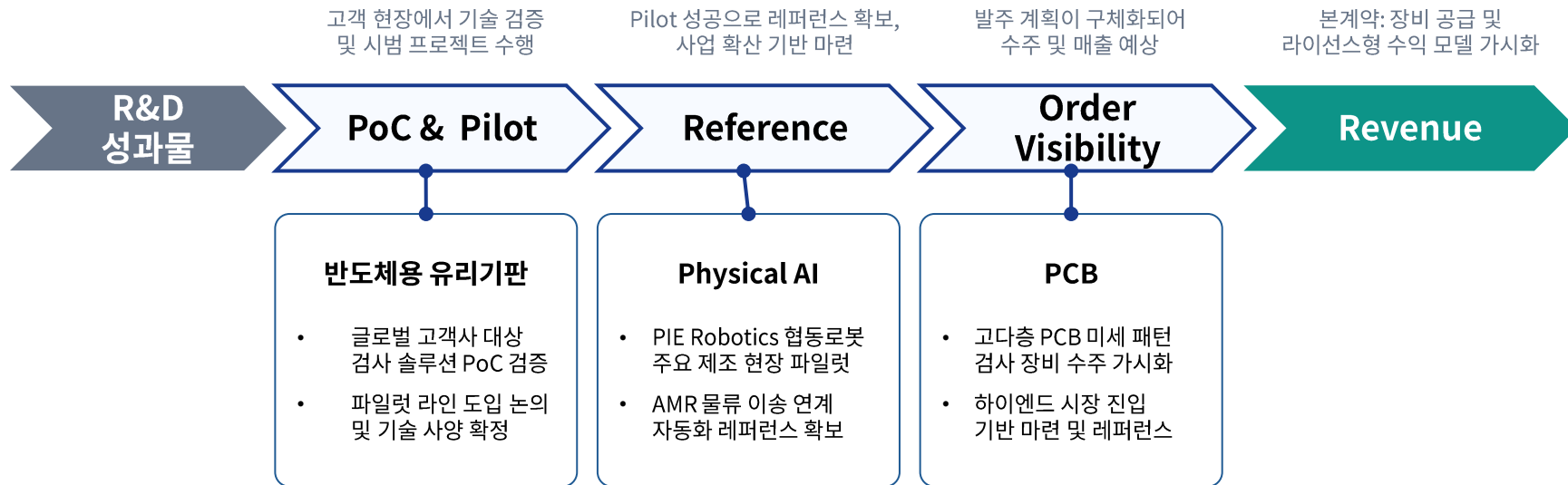
- ✓ End-to-End Smart Factory
- ✓ H/W + S/W + Robot Integration

적용 산업 도메인 확장



04 2026~2027년 주요 모멘텀

R&D 성과물의 사업화 + 매출로 시현되는 원년



기술 검증(PoC) 완료된 프로젝트들이 **실질 매출로 전환** 예정
유리기판 및 로봇틱스 등 신사업 포트폴리오의 **매출 개시** 예정

05 신규사업 매출 가시화, AX사업부

고부가가치 검사 + 1차 벤더 장비 Biz. → 수익구조 고도화

기존 사업 구조

소프트웨어 중심

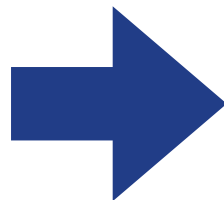
단순 알고리즘 라이선싱 및
S/W 영역 위주

2차 벤더 밸류체인 의존

장비 제조사를 통한 간접 납품
마진 구조의 한계

프로젝트성 매출

일회성 수주 비중이 높아
실적 변동성 존재



AX 사업부, 신규사업

고부가가치 검사장비

H/W + AI S/W 통합 솔루션
ASP(평균판매단가) 상승 효과

1차 벤더 장비 Biz.

글로벌 Top-tier 제조사 직접 대응
고객 파트너십 강화

Repeat Order + 산업 다각화

반도체용 유리기판 등 하이엔드 시장 진입
수익성 및 확장성 확보

- 01 이차전지
- 02 반도체용 유리기판
- 03 PCB
- 04 Automotive
- 05 Logistics
- 06 PoC to Revenue 전환
- 07 중장기 확장 로드맵

03

Growth Momentum

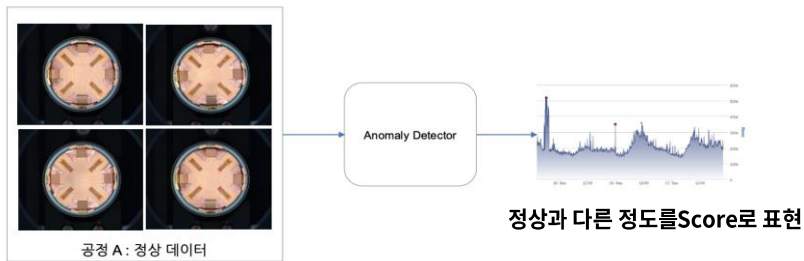


Investor Relations 2026

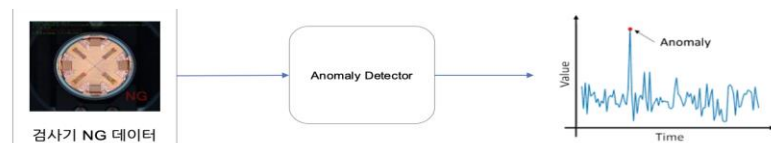
01 이차전지 (M/V sol + Physical AI + AI Ops)

차별성 없는 M/V solution 경쟁은 지양 멀티모달 데이터 기반 / AI Ops 와 동시 제안으로 스마트팩토리 구현을 유도

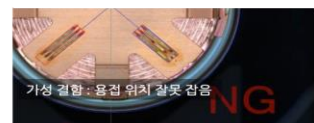
학습: 공정별 정상 데이터를 Anomaly Detector 모델을 통해 학습



인퍼런스: 검사기에서 판단한 NG 데이터를 Anomaly Detector 모델을 통해 추론



특정 기준치 보다 스코어가 높을 시 진성 NG, 그 외는 가성 NG로 알람 표출



Smart Factory

Data Ops / AI Ops

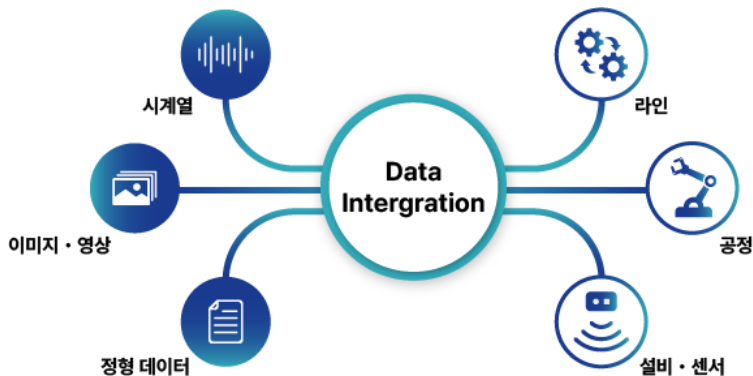
Multimodal A/D

M/V Solution



01 이차전지 (M/V sol + Physical AI + AI Ops)

High end M/V + Data Ops + AI Ops 연계 제안으로 배터리 라인의 지능화, AX를 선도



열화



공정 속도 변경



접지 문제



새로운
결함 유형 등장



조명 노후화



카메라 위치/각도 변경



센서 노후화



품질 기준 변경



케이블 접촉 불량



재질 반사 특성 변경



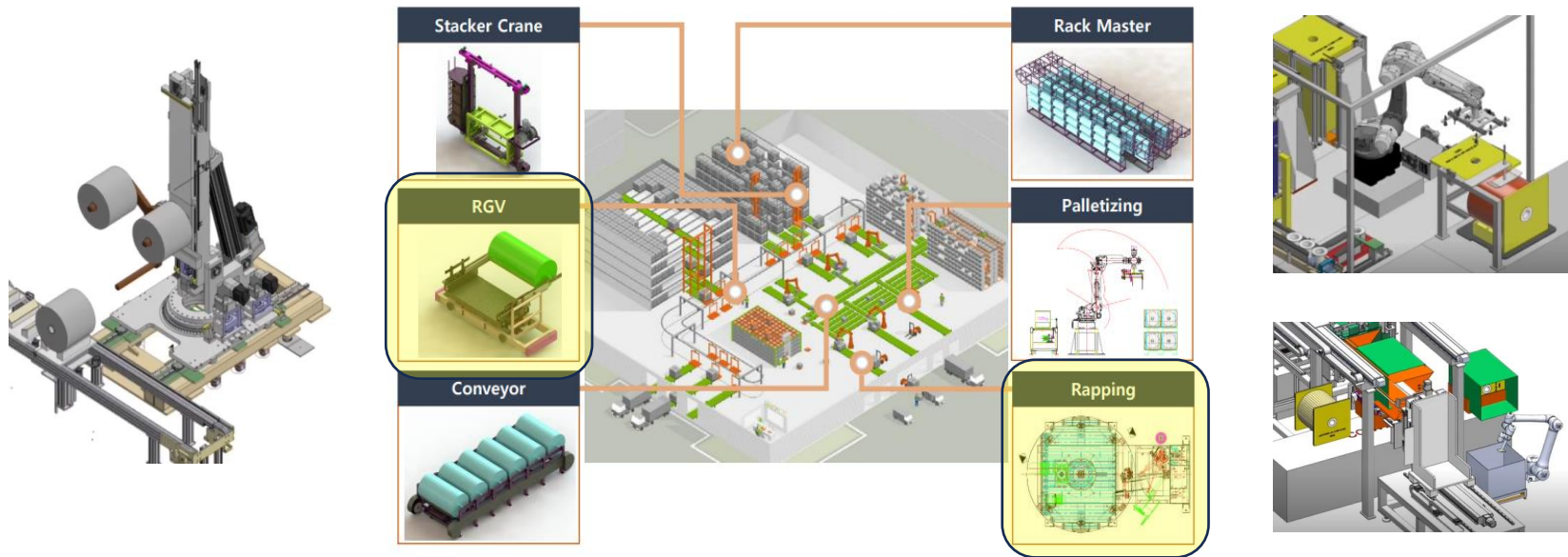
환경 조명 간섭



카메라 렌즈 오염

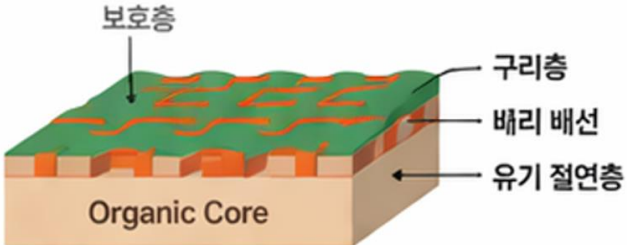
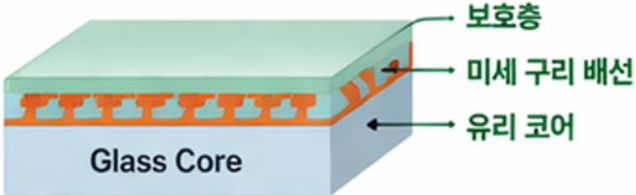
01 이차전지 (M/V sol + Physical AI + AI Ops)

AI 기반 물류 전체 영역, 로봇틱스 자동화 / 무인화
단위 공정 로봇틱스 및 공정 간 물류 자동화, 스마트 관제 시스템 통합운영 가능



02 반도체용 유리기판 (M/V sol + Inspection H/W + AI Image Enhancer)

AI 데이터센터 / 서버의 용량 증가와 속도 증가에 대한 니즈
유리기판 → AI device 고사양화 / 대면적화의 Pain Killer

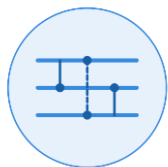
기존 유기기판 (Organic Substrate)	유리기판 (Glass Substrate)
	
<ul style="list-style-type: none"> • 표면 거칠고 평탄도 낮음 → 미세 배선 한계 • 배선 밀도 제한적 • 휨(Warpage) 발생 가능성 높음 • 고속 신호 손실 큼 	<ul style="list-style-type: none"> • 매우 평탄한 표면 → 초미세 배선 가능 • 고밀도 라우팅 구현 • 뛰어난 기계적 안정성 (휨 최소화) • 낮은 유전손실 → 고속 신호 전송 유리

출처: Fraunhofer IZM (TGV Integration), AGC (Through Glass Via Technology), 당사 영업팀

02 반도체용 유리기판 (M/V sol + Inspection H/W + AI Image Enhancer)

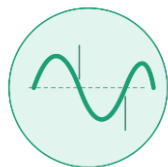
유리기판 산업은 경쟁이 치열한 레드오션이 아닌 승자독식의 블루오션

이차전지, 디스플레이 등과 달리 성숙된 기술력이 확보되지 않아... 혁신 기술에 대한 보상이 큰 시장



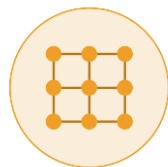
초고밀도 배선 구현

- 미세 패턴 형성으로 칩 간 거리 단축
- 고집적 인터커넥트 가능



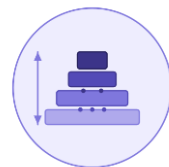
우수한 신호 품질 (Low Loss)

- 낮은 유전손실(Dk, Df)
→ 고속 데이터 전송 유리



열 · 기계적 안정성

- 낮은 열팽창계수(CTE)로 휨 최소화, 대면적 패키징 가능



대형 패키징 대응력

- GPU + HBM 등 대형 Chiplet 구조에 최적화된 기판

02 반도체용 유리기판 (M/V sol + Inspection H/W + AI Image Enhancer)

유리기판 제조공정에서, 불량 검출은 사업의 성패를 가르는 요소
유리기판 사업에서 불량 검사기는 수율/생산성의 이슈가 아닌, 사업 존속 여부를 결정

Odd TGV hole

Micro crack

Cu void

Delamination

누적되는 공정 비용

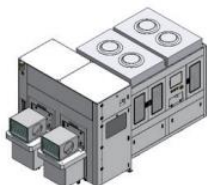
불량 관리 난이도 상승

**FATAL &
IRREVERSIBLE Loss**



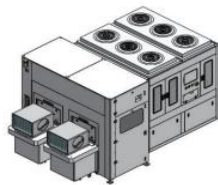
02 반도체용 유리기판 (M/V sol + Inspection H/W + AI Image Enhancer)

유리기판 공정불량에 대한 광범위한 커버리지 제공
광학, 홀로토크그래피, X-ray CT, 초음파 등 다층적 기술역량을 보유



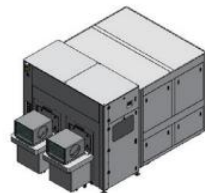
TGV AOI (GAVI)

Size / Position / Roundness
/ Taper Angle
Hole Array / Hole Pitch
/ Cavity / Dimension /
Thickness /
Defects(Chipping, Scratch,
Crack, Dirt, So on)



**Holotomography
(GAVIH)**

TGV 3D Reconstruction /
Hole Roughness /
Micro-Crack



**X-Ray CT
(piXion)**

Void / Bump Crack /
Delamination



**SAM
(PASAM)**

Void / Delamination

03 PCB (Physical AI + Inspection H/W + AI Ops)

AI 산업의 급성장으로 인해, PCB 제조사 및 하부 밸류체인에 커다란 기회 도래
 그러나, 레드오션이었던 PCB 밸류체인에서 주목할만한 R&D 성과물이나 선도기술은 부족

PCB Evolution: Mobile → Server → AI 구조/스펙 비교

구분	저사양 PCB (Mobile/Display)	서버용 PCB	AI/고성능 PCB (GPU/AI Accelerator)
주요 용도	스마트폰, 카메라모듈, 디스플레이	서버 메인보드, 네트워크 장비	AI GPU, HPC, 데이터센터 가속기
Layer 수	4~10층	12~20층	20~40층 이상 (고적층)
기판 크기	소형 (수 cm)	중형	대형 (수십 cm 이상)
배선 미세도 (L/S)	40~60μm	30~50μm	10~30μm 이하 (초미세)
Via 구조	Through Hole 중심	Build-up + 일부 Microvia	Full Build-up + Stacked Via
소재	FR-4	고속 저유전 소재 일부 적용	저유전/저손실 고급 소재 (Megtron 등)
신호 특성	저속/중속	고속 신호 일부	초고속 신호 (PCIe, HBM, SerDes)
열관리	낮음	중간	매우 중요 (고발열 GPU 대응)
생산 난이도	낮음	중간	매우 높음

출처: 당사 영업팀

03 PCB (Physical AI + Inspection H/W + AI Ops)

고사양, 고부가가치 PCB에 대한 수요 급증

⇒ 무인화 / 자동화 검사 및 로봇틱스 AI, R&D 성과에 대한 PCB 시장의 기대감 상승

왜 지금 기회인가?

고사양 PCB 수요 증가

- AI 데이터센터·AI 서버·고성능 네트워크 투자 확대
- 가속기·고속전송 대응용 고사양 PCB 채택 비중 상승
- 전장·산업용 전자기기 고도화로 적용 영역 지속 확대

제품 난이도와 부가가치 상승

- 고면적·고다층·미세회로화로 제조 정밀도 요구 급상승
- MLB·FC-BGA 등 고부가 PCB 중심으로 품질 기준 강화
- 내부 홀·정렬·미세 단선 등 난해한 결함 대응 필요

PIE는 어떻게 준비되어 있는가?

PCB와 AI를 동시에 선제 준비

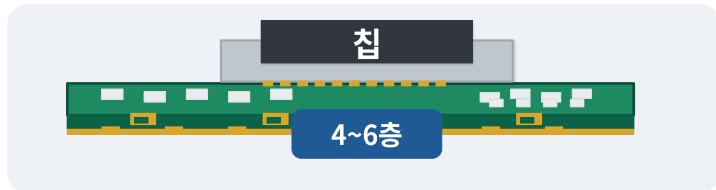
- PCB 공정에 대한 이해를 기반으로 AI 적용 R&D를 선제 수행
- PCB 공정에 특화된 AI 및 자동화 R&D 성과 확보 (CNC Driller, 안전 펜스, 통합 관제 등)
- 검사-자동화-데이터 운영까지 PCB 제조 전 공정 대응 가능

투자과 밸류체인 확장 기대

- 국내외 주요 제조사 중심 CAPA·라인 증설 투자 확대
- 삼성전기·대덕전자 등 고사양 기판 중심 투자 지속
- 제조-검사-자동화-데이터 운영까지 밸류체인 수요 확산

03 PCB (Physical AI + Inspection H/W + AI Ops)

대면적, 고적층, 고정밀 PCB 제조공정은 60-70% 이하의 저조한 수율이 현실
PIE, “불량 검사 고도화 + 무인화 & 자동화”로 해법 제안



- 적층 4~6층
- 소형 기판
- 상대적으로 단순한 배선
- 단순 구조



- 적층 16~24층
- 대형 기판
- 고다층 배선
- 고급 패키징 구조

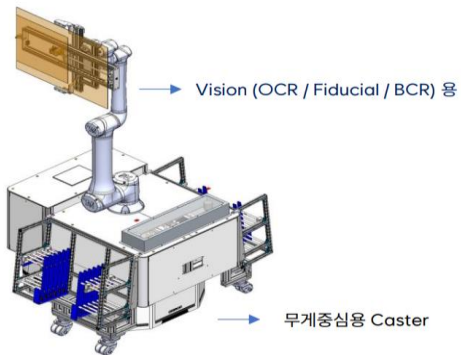
03 PCB (Physical AI + Inspection H/W + AI Ops)

PCB 제조라인 중, 무인화 / 자동화 니즈가 가장 높은 드릴 공정 무인화 수율 / 인건비 절감 상승의 복합적 기대 효과

CNC Driller Automation

AI 기반 AMR 협동로봇 기반 자재 이송

Size	AMR, 협동로봇 Payload 고려 선정
Takt Time	User Spec.
Composition (H/W, S/W)	협동로봇(6축), AMR(라이다, 카메라 내장) 2D Vision 카메라, Gripper / AI Model(학습), ROS, 제어 알고리즘, MES/ERP

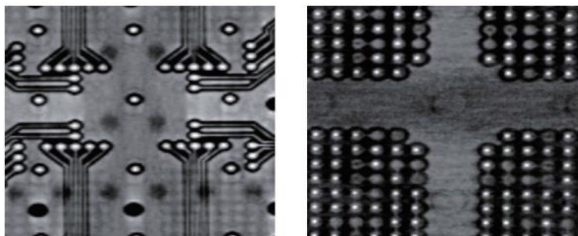


Key Point

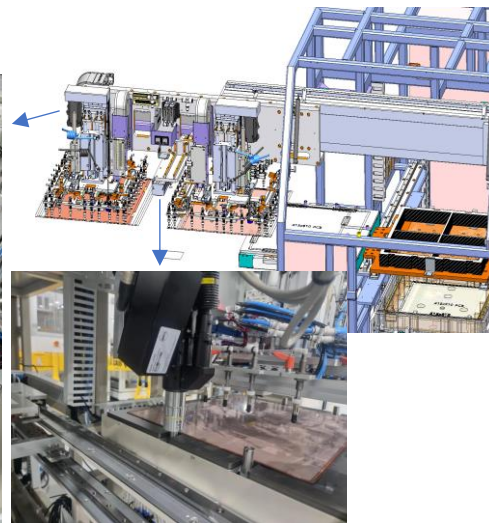
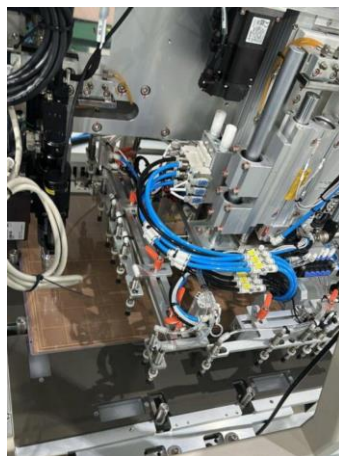
- ▷ AI 기반 관제 시스템 이용, 실시간 이상감지 및 예지보전
- ▷ 지능형 스마트카메라로 Aling, Vision Inspection
- ▷ 고중량 물체 취급 및 Gripper를 이용한 다양한 형상 취급 가능

03 PCB (Physical AI + Inspection H/W + AI Ops)

피아이이로보틱스 (자동화 장비) + 피아이이 (BVH/PTH) 동시 제안



- AI-Powered AFVI(Automated Final Visual Inspection) Solution
- PCB Hole (PTH, BVH) AOI Solution
- Pattern AOI Solution
- AI-Powered Proactive Prevention of Performance Degradation



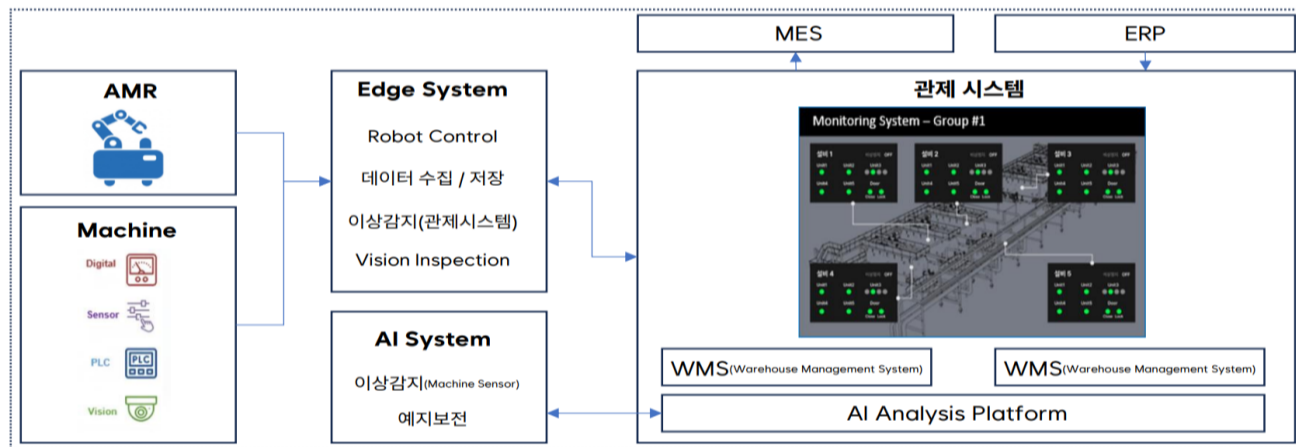
“직교로봇 + Inspection H/W + 진동 보정 AI가 결합된 하이브리드 Physical AI”

※ BVH/PTH : Blind Via Hole / Plated Through Hole, 비관통형 / 관통형 검사기

03 PCB (Physical AI + Inspection H/W + AI Ops)

피아이이로보틱스 & 아하랩스 : 무인화/AMR 통합관제 + AI 안전펜스 제안 → 해당 R&D 성과, 방위산업 AX에도 적용

통합관제 시스템 — AI 기반 AMR, Machine Data 수집, 분석 예지 보전



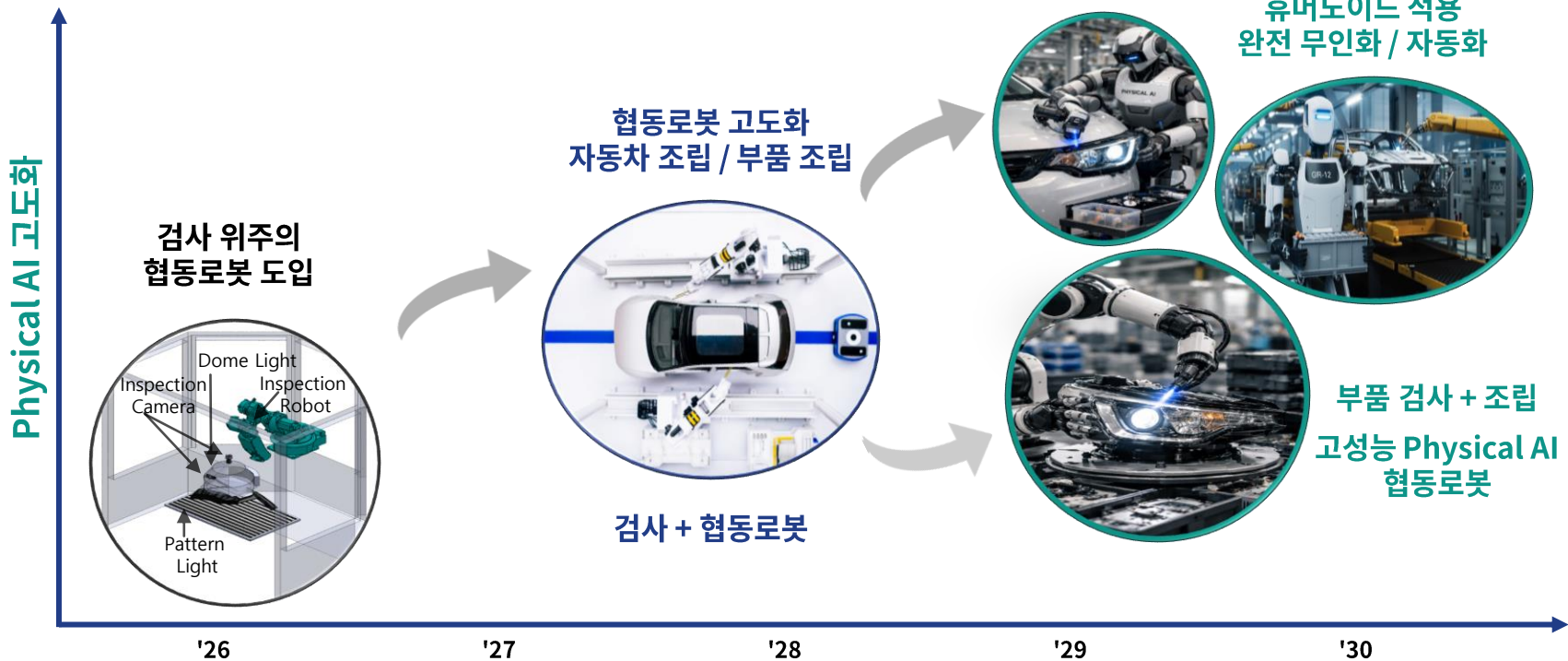
Key Point

- ▷ AI(Data) Drift로 AMR / Machine 입·출력 값 추적 관리
- ▷ MES, ERP, WMS, WES 등과 연동 및 통합 관리 가능

04 Automotive (Physical AI + Inspection + AI Ops)

자동차 제조 공정에서 조립+검사 Physical AI 장비의 도입은 이미 현실화

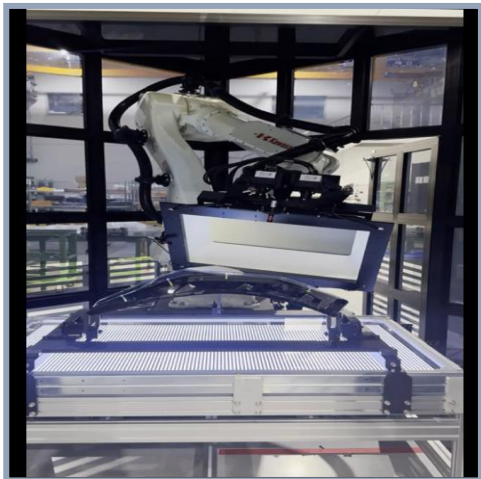
→ 하부 밸류체인 (1, 2차 벤더) 확장 가능성에 주목



04 Automotive (Physical AI + Inspection + AI Ops)

완성차 제조공정의 발전 방향은 휴머노이드 + 무인화

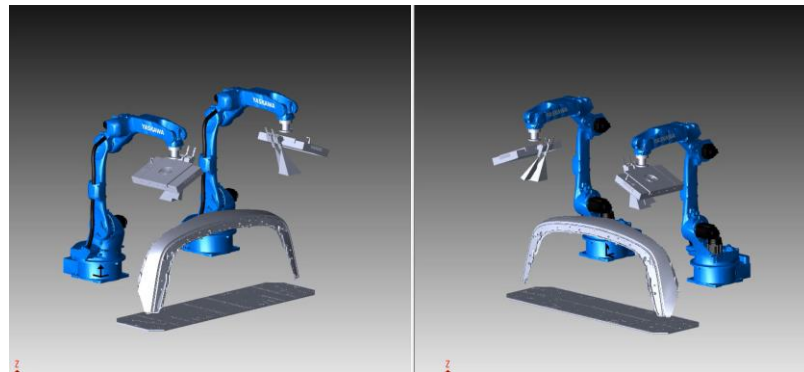
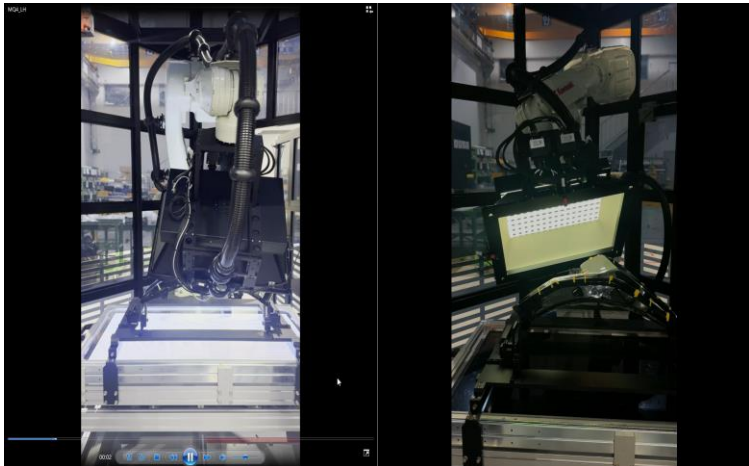
→ 하부 밸류체인(1, 2차 벤더사)의 발전 방향은 협동로봇 + Physical AI 무인화 / 검사



04 Automotive (Physical AI + Inspection + AI Ops)

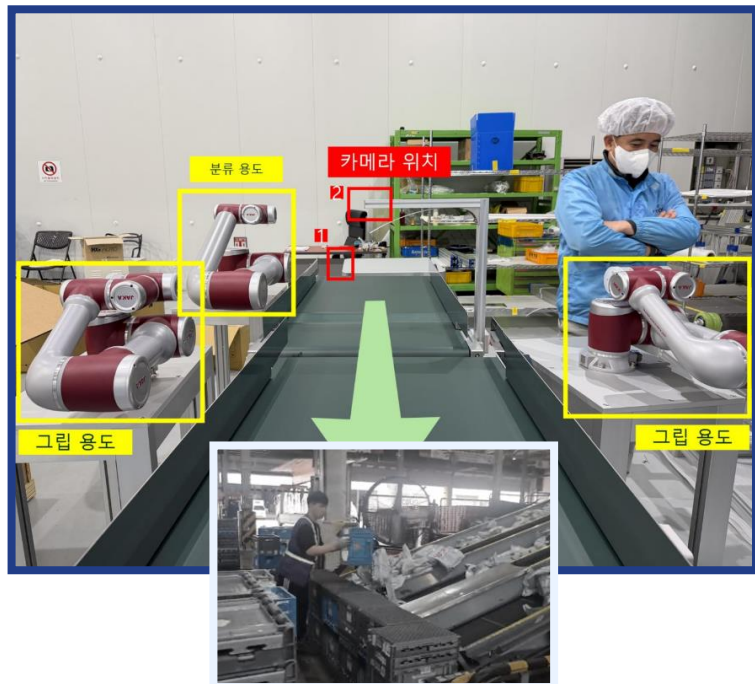
당사 기술 기반 Inspection·AI Ops 무인화 장비 토탈 솔루션 보유

→ 레퍼런스 확보 및 매출 시현



05 Logistics (Physical AI + Inspection H/W + AI Ops)

AI CCTV + Physical AI 기술 고도화를 통한,
비정형 폴리백 인식 + Gripper → 물류 작업 무인화 솔루션 제안



05 Logistics (Physical AI + Inspection H/W + AI Ops)

단순 입력/설계된 반복 작업 로봇과 차별되는 로봇틱스 AI 기술 고도화

→ 물류 이동/분류/검사의 핵심은 Detection & Gripper

다중 폴리백 Segmentation

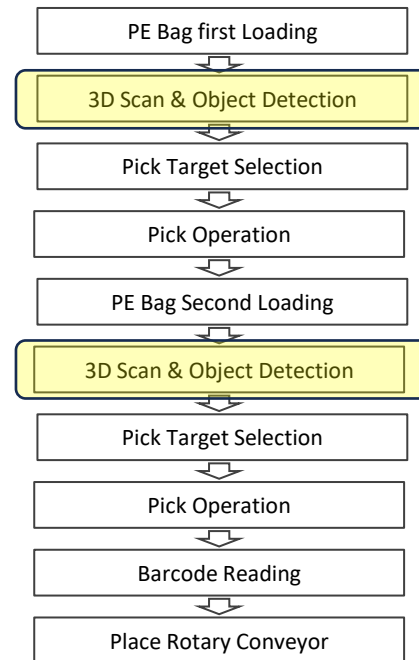
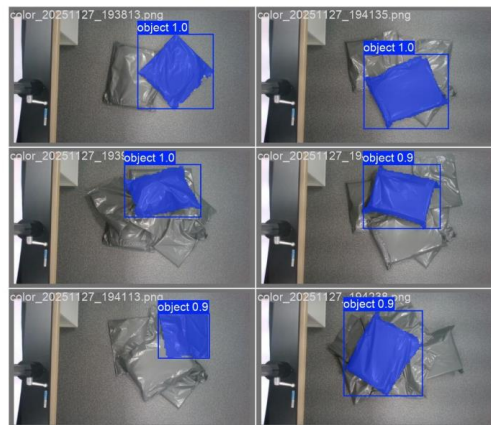
Semantic Segmentation



Semantic Instance Segmentation



최상단 폴리백 Detection



06 PoC to Revenue 전환

기술 검증 단계를 넘어 실제 수주·매출로 연결되는 수익화 구간 진입 중

01

PoC

(Proof of Concept)

고객 요구사항 기반 기술 타당성 검토 및 초기 알고리즘 모델링 수행

- ✓ 기술 타당성(Feasibility) 검증
- ✓ 커스텀 알고리즘 설계
- ✓ Lab Scale 샘플 테스트

02

Pilot

(Field Test)

실제 생산 라인 적용을 통한 성능 안정화 및 양산 적합성 평가

- ✓ 현장 라인(On-site) 설치 운영
- ✓ 검출/가동률 최적화
- ✓ 시스템 연동 안정성 확보

03

Revenue

(Order & Expansion)

공급 계약 체결을 통해 매출 인식 및 타 라인 수평 전개

- ✓ 본 계약(Mass Production) 체결
- ✓ 장비 공급 및 라이선스 매출
- ✓ 유지보수 및 추가 수주

Target Domains

반도체용 유리기관 / PCB

오토모티브

반도체 / 모바일 / IT

케미칼 / 국방 / 메디칼

커머스 / 파이낸스

07 증장기 확장 로드맵

P.A.R.C.

PIE AI R&D Campus

PIE

AI Vision Inspection

+

PIE Robotics

Automation & Robots

+

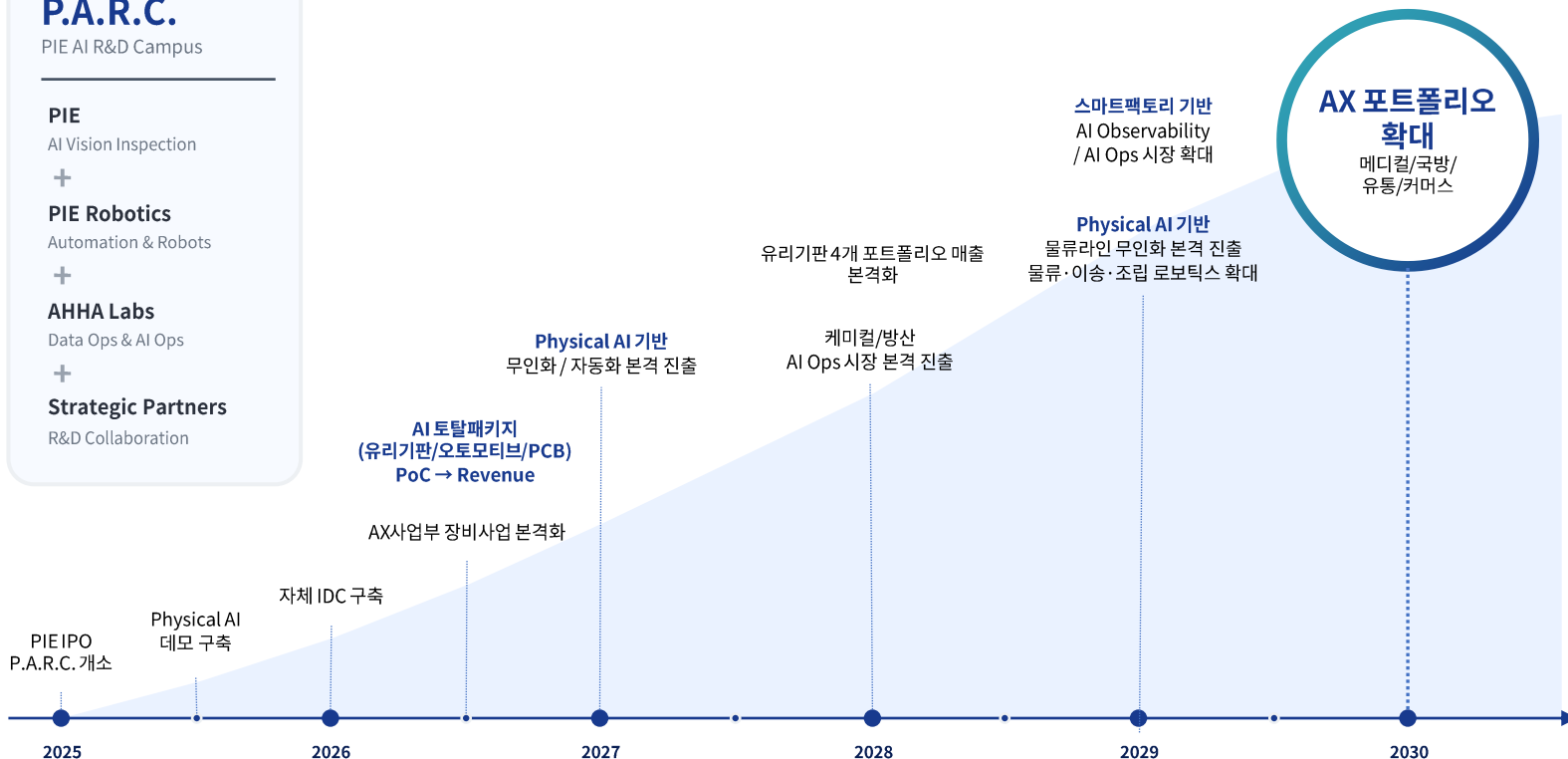
AHHA Labs

Data Ops & AI Ops

+

Strategic Partners

R&D Collaboration



01 요약 재무제표(별도)

02 요약 재무제표(연결)

03 핵심기술 내재화 및 수직계열화 구축

04 Man Power

Appendix



Investor Relations 2026

01 요약 재무제표 (별도)

재무상태표

(단위: 백만원)

구분	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
유동자산	40,693	58,022	47,999	49,024
비유동자산	12,607	15,929	22,458	72,465
자산총계	53,300	73,951	70,456	121,489
유동부채	21,412	33,302	18,864	18,010
비유동부채	109	877	871	49,420
부채총계	21,522	34,179	19,735	67,430
자본금	1,071	3,212	3,212	3,588
자본잉여금	16,413	14,260	14,260	40,293
이익잉여금	14,216	22,185	33,020	9,899
자본총계	31,779	39,773	50,721	54,058

손익계산서

(단위: 백만원)

구분	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
매출액	28,595	41,346	65,030	18,965
매출원가	19,927	30,327	47,607	25,905
매출총이익	8,669	11,019	17,422	(6,940)
판매비와관리비	1,923	4,234	7,683	10,849
영업이익	6,746	6,785	9,739	(17,789)
영업외수익	707	1,676	2,021	3,956
영업외비용	1,384	877	1,414	7,846
법인세차감전순이익	6,069	7,584	10,347	(21,679)
법인세비용	341	(385)	(488)	1,441
당기순이익	5,728	7,969	10,834	(23,120)

02 요약 재무제표 (연결)

재무상태표

(단위: 백만원)

구분	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
유동자산	53,653	71,446	66,760	72,839
비유동자산	18,224	21,700	31,285	77,399
자산총계	71,877	93,146	98,045	150,238
유동부채	34,073	48,680	40,315	38,647
비유동부채	2,911	3,927	5,898	55,247
부채총계	36,984	52,607	46,213	93,894
자본총계	34,893	40,539	51,832	56,344

손익계산서

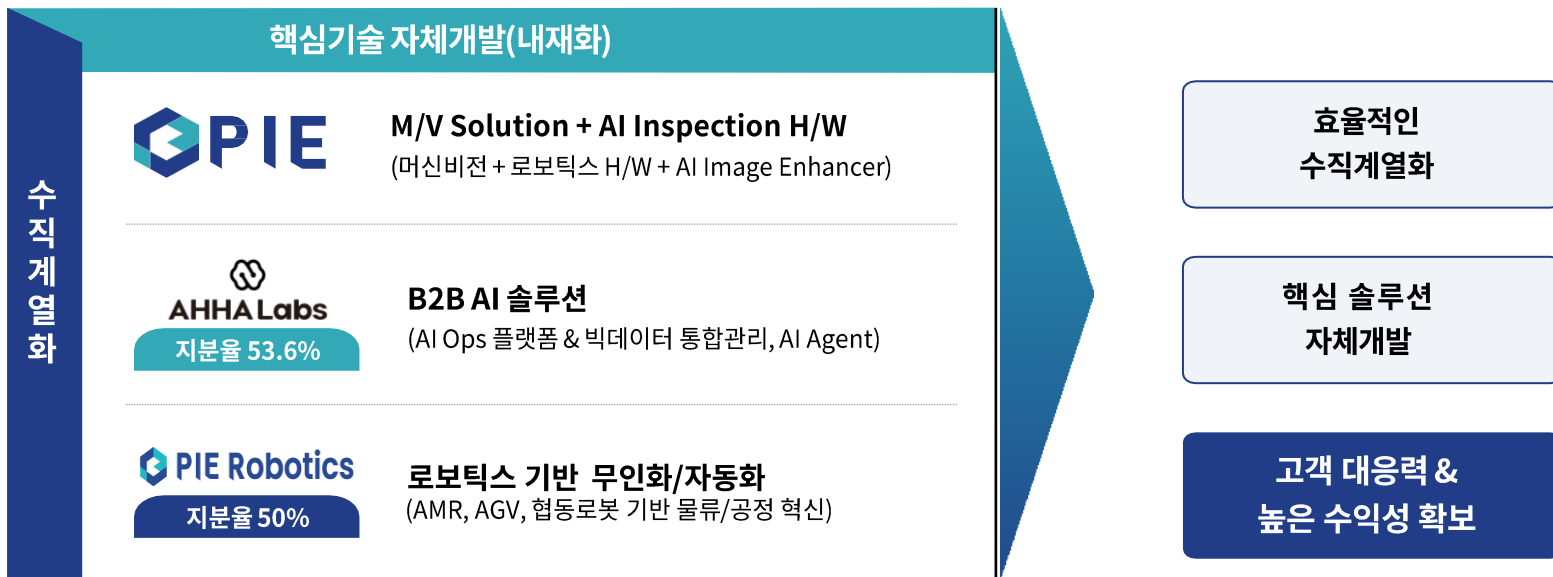
(단위: 백만원)

구분	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
매출액	55,431	85,838	124,048	65,088
매출원가	42,763	72,877	101,326	70,105
매출총이익	12,668	12,961	22,722	(5,017)
판매비와관리비	4,544	8,967	13,289	16,201
영업이익	8,124	3,994	9,433	(21,218)
당기순이익	6,959	5,511	9,948	(24,612)

03 핵심기술 내재화 및 수직계열화 구축

수직계열화 및 핵심기술 자체개발로 Turn-key & one-stop 솔루션 제공

→ AX 시장을 선도하는 고객 대응력 & 수익성



04 Man Power

B2B 고객의 AX 대응, 차세대 AI 기술 선도, 자본시장 친화적 확장 등, AI 기반 R&D 및 사업화에 적합한 경영체제 구축

대표이사
최정일

- 서강대학교 전자공학 석사
- 삼성SDI 과장
- 다이어티 부사장
- 현) 피아이어 대표이사



AI 중점 사업화와 R&D 추진에 대한
최대주주의 강한 의지에 따른 P.A.R.C. 출범
오너 중심 책임경영 체제 본격화

사업부 단위 책임 경영체제 구축

SB사업부장

김종신
부사장

- 연세대학교 경영학 학사/석사
- 삼성코닝 / 일본 삼성전자 기획실 과장
- eSamsung Japan 대표
- 삼성전자 무선사업부 B2B 영업 상무
- 이트너스(주) B2B 본부장 전무
- 현) 피아이어 SB사업부장

AX사업부장

윤형석
부사장

- 연세대학교 공과대학 석사
- 삼성SDI 차장
- 에이앤에스 이사
- 에스앤유 이사
- 에스에프에이 상무 (R&D센터장)
- 현) 피아이어 AX사업부장

경영전략총괄

김태성
부사장

- 포항공과대학교 신소재공학 학사/석사
- 푸르멘셀투자증권 과장
- 코웰창업투자 이사
- 알바트로스인베스트먼트 전무이사
- 아우름자산운용 대표이사
- 솔리크인베스트먼트 대표이사
- 현) 피아이어 경영전략총괄 부사장

Better partner for your AX

Thank you

피아이는 고객의 AX (AI Transformation)을 위해 끊임없이 도전하고 있습니다.
앞으로도 기술혁신을 통해 고객과 함께 성장하고, 주주이익을 우선하는 기업이 되겠습니다.

